



主要特点

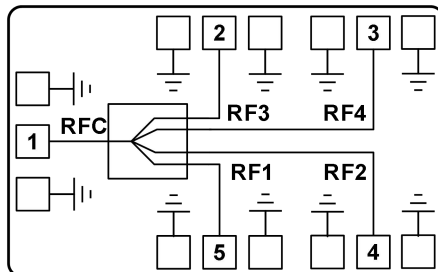
频率范围: 2 - 18 GHz

插入损耗: 2.0 dB

输入/输出: 50 Ohm 匹配

芯片尺寸: $3 \times 4 \times 0.1 \text{ mm}^3$

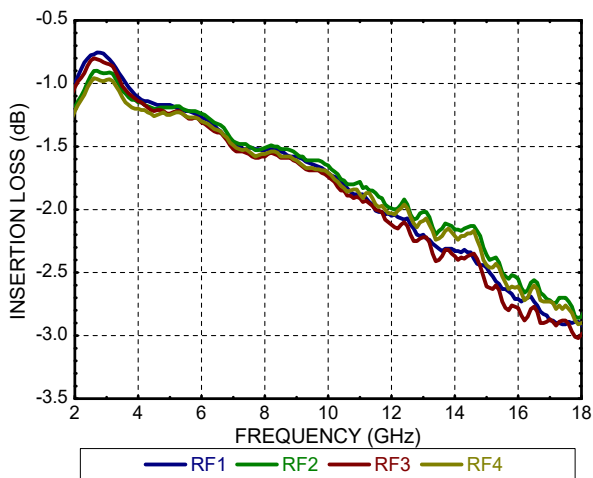
功能框图



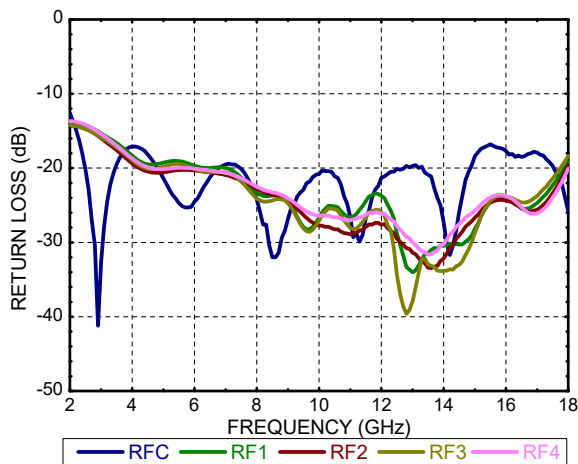
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $P_{in} = 0 \text{ dBm}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	2 - 18			GHz
插入损耗		2.0		dB
平坦度		± 1.0		dB
隔离度		25		dB
回波损耗		18		dB

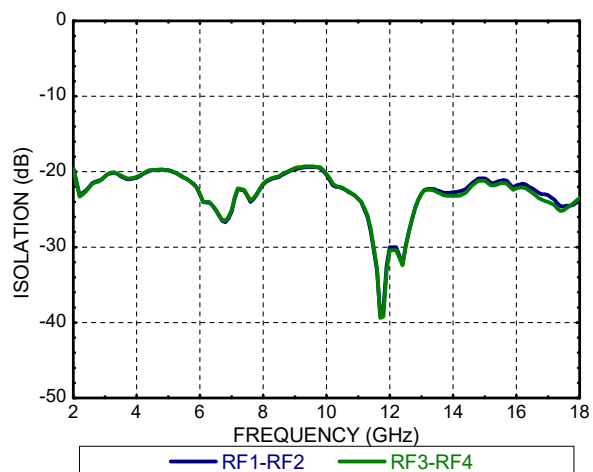
插入损耗



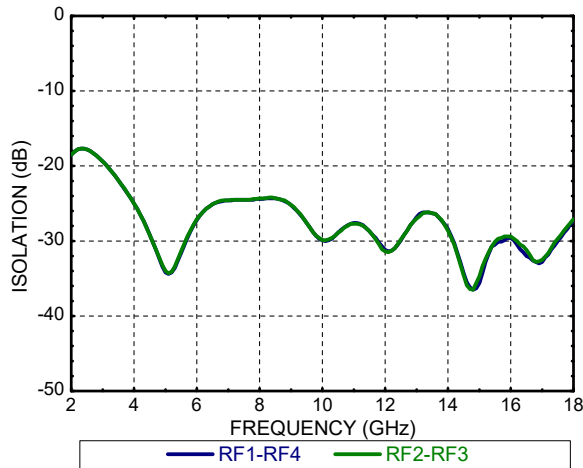
回波损耗



邻向隔离度

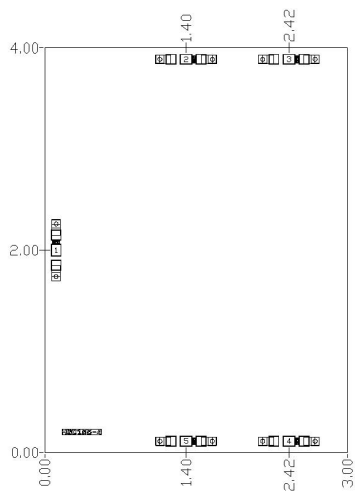


对向隔离度



物理参数

单位: mm



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	RFC	该焊盘是射频公共端
2	RF3	该焊盘是射频支路端
3	RF4	该焊盘是射频支路端
4	RF2	该焊盘是射频支路端
5	RF1	该焊盘是射频支路端

注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100 μm
3. 典型键合焊盘尺寸为 $120 \times 100 \mu\text{m}^2$
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN+PBO；厚度：0.5+1.6 μm

极限参数

1. 射频输入功率：+37dBm
2. 储存温度：-65 ~ +150 $^{\circ}\text{C}$
3. 工作温度：-55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$